

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

엠케이전자 (033160)

새로운 수요처가 열리는 본딩와이어

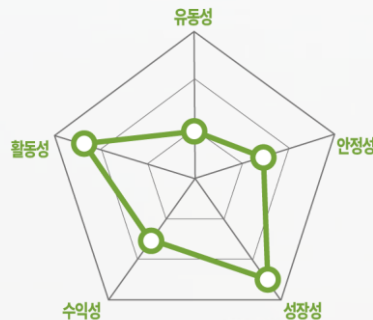
체크포인트

- Vera Rubin부터 SoCMM2 채택이 본격화되며 2027년부터 국내 메모리 고객사향 본딩와이어 수요 증가 예상. LPDDR5X 고적층 패키지 구조 특성상 Die당 Wire Bonding 적용이 반복돼 모듈당 본딩와이어 사용량 증가 전망
- CXMT와 YMTC의 CAPA 확대가 이어지는 가운데 중국 업체의 범용 DRAM 및 NAND 공급 비중이 상승할 전망. 이에 따라 기존 시스템반도체 및 OSAT향 Coated Wire 중심이었던 중국법인의 수요처가 메모리향 Gold Wire까지 확대될 것으로 예상
- 2026년 매출액은 1.98조 원(+41.3% YoY), 영업이익 1,090억 원(+668.5% YoY)을 전망. 본딩와이어 외형 성장과 솔더볼 판가 정상화, 고마진 Pd Alloy 매출 확대, 금융 부문 실적 회복이 이익 개선을 견인할 전망

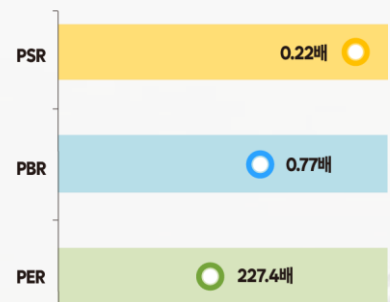
주가 및 주요이벤트



재무지표



밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

엠케이전자 (033160)

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김지은 jekim0216@kirs.or.kr

KOSDAQ

반도체와반도체장비

반도체 본딩와이어 제조 업체

1982년에 설립되어 1997년 코스닥 시장에 상장한 반도체 소재 업체. 주요 사업은 반도체 소재 및 금융 사업 등. 1H26 연결 기준 매출 비중은 반도체 소재 89.2%, 금융 10.8%를 기록. 금융 및 기타 사업을 제외한 반도체 소재 매출 기준 제품별 비중은 본딩와이어 91.5%, 솔더볼 3.5%, 스퍼터링 타겟 2.3%, 골드 증착재 0.5%, 기타 제품 2.3%를 기록

SoCAMP2와 중국 메모리 CAPA 확대에 따른 본딩와이어 수요 증가

Vera Rubin부터 SoCAMP2 채택이 본격화되고 중국 메모리 CAPA 확대가 이어지면서 동사의 본딩와이어 수요 증가 전망. SoCAMP2는 LPDDR5X 고적층 구조 특성상 Wire Bonding 사용량이 많아 2027년부터 국내 메모리 고객사 물량 증가에 따른 수혜 예상. 동시에 CXMT, YMTC 증설로 중국 메모리 패키징 수요가 확대되면서 기존 Coated Wire 중심의 중국법인 수요가 Gold Wire까지 확대될 전망. 선두 메모리 업체의 고부가 제품 집중과 중국 업체의 범용 메모리 공급 비중 확대로 중장기 본딩와이어 수요 증가 지속 판단

큰 폭의 수익성 개선 기대되는 2026년

2026년 매출액은 1.98조 원(+41.3% YoY), 영업이익 1,090억 원(+668.5% YoY)을 전망. 주요 고객사의 생산 증가와 중국 시스템반도체 및 OSAT향 Coated Wire 수요 확대, 금 가격 상승에 따른 ASP 상승으로 본딩와이어 매출액은 1.6조 원(+62.1% YoY)을 예상. 솔더볼의 판가 정상화와 고마진 Pd Alloy의 매출 확대에 따른 이익 기여도 확대 전망. 금융 부문 실적 회복까지 더해지며 연결 OPM은 2026년 5.5%로 상승할 것으로 기대

Forecast earnings & Valuation

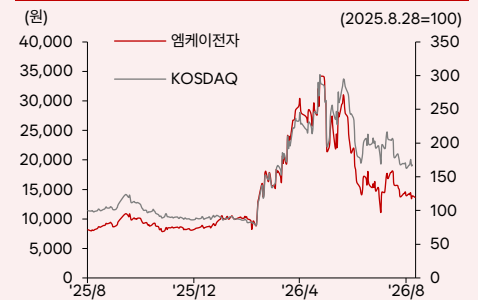
	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억 원)	10,232	11,170	11,706	14,038	19,842
YoY(%)	6.8	9.2	4.8	19.9	41.3
영업이익(억 원)	803	465	561	142	1,090
OP 마진(%)	7.8	4.2	4.8	1.0	5.5
지배주주순이익(억 원)	-116	-352	-269	13	770
EPS(원)	-531	-1,602	-1,218	60	3,211
YoY(%)	적전	적지	적지	흑전	5,253.7
PER(배)	N/A	N/A	N/A	140.1	4.2
PSR(배)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
EV/EBITDA(배)	11.6	17.6	20.9	55.2	17.0
PBR(배)	0.6	0.7	0.4	0.5	0.7
ROE(%)	-2.9	-9.2	-7.5	0.4	18.6
배당수익률(%)	0.9	0.8	1.5	1.4	0.9

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재가(9/9)	13,610원
52주 최고가	34,200원
52주 최저가	7,860원
KOSDAQ (9/9)	830.37p
자본금	113억원
시가총액	3,343억원
액면가	500원
발행주식수	25백만주
평균거래량(60일)	94만주
평균거래대금(60일)	164억원
외국인지분율	12.25%
주요주주	오션비홀딩스 외 2인 32.31%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-19.1	54.7	58.3
상대주가	-22.2	105.3	57.2

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '이자보상배율', 성장성 지표는 'EPS증가율', 수익성 지표는 'EBITDA마진율', 활동성지표는 '재고자산회전율', 유동성지표는 '당좌비율임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 엠케이전자는 반도체 패키징 소재 전문기업

본딩와이어, 솔더볼 등
반도체 패키징 소재 제조·판매
전문기업

엠케이전자는 1982년 골드 본딩 와이어 등 전자부품의 제조·판매를 목적으로 (주)미경사라는 사명으로 경기도 용인에 설립된 반도체 패키징 소재 전문기업이다. 귀금속 가공 기술을 기반으로 1983년 골드 본딩 와이어 제조기술을 자체 개발해 특허를 취득하며 사업을 본격화했고, 1986년 용인공장을 설립해 양산체계를 갖췄다. 이후 1997년 사명을 엠케이전자(주)로 변경하고 같은 해 코스닥시장에 상장했다.

동사는 설립 초기 반도체 칩과 리드프레임을 전기적으로 연결하는 골드 본딩 와이어를 중심으로 사업을 전개했다. 이후 2001년 반도체와 기판을 접합하는 솔더볼 사업에 진출했고, 2005년 구리 와이어 사업을 개시했으며, 2008년에는 금-은 합금 본딩 와이어를 세계 최초로 양산하고 구리 본딩 와이어 전용 생산라인을 구축했다. 이어 2018년 솔더 페이스트, 2023년 팔라듐(Pd) 합금 사업을 잇달아 개시하며 접합소재 제품군을 넓혀 왔으며, 반도체 소재 제조 과정에서 발생하는 귀금속을 회수·재생하는 사업도 병행하고 있다.

본업 외에도 동사는 2000년대 후반부터 신성장 동력과 수익원 다각화를 위해 사업 영역을 넓혀 왔다. 2007년에는 구리 등 원재료 공급선 확보를 목표로 키르기스스탄 구리광산 개발 등 자원개발에 진출했으나, 상업 생산에 이르지 못한 채 관련 법인이 청산되며 정리됐다. 2013년부터 2015년에 걸쳐서는 투자 자회사를 통해 부동산신탁 기업 한국토지신탁을 인수해 최대주주로 편입했다. 이어 2021년에는 ESG 경영 강화와 신성장 동력 확보 차원에서 환경관리 기업 동부엔텍을 인수했다. 다만 2026년 상반기 동부엔텍 지분 전량을 매각하고 관련 환경관리부문을 중단영업으로 분류하는 등, 최근에는 본업인 반도체 소재 사업에 역량을 집중하는 방향으로 사업 구조를 재편하고 있다.

생산 기반 측면에서는 용인 본사 공장을 시작으로 2008년 시흥공장, 2018년 음성공장, 2025년 인천공장을 순차적으로 준공하며 생산능력을 확충해 왔다. 해외에서는 2001년 대만법인과 2009년 중국법인을 설립한 데 이어 2025년 베트남법인을 설립하며 생산·판매 거점을 넓혀 왔다. 대외적으로는 2004년 1억 불을 시작으로 2011년 6억 불 수출의 탑을 수상했다. 이를 바탕으로 현재 본딩와이어와 솔더볼을 중심으로 한 반도체 패키징 소재를 제조하고 있다.

엠케이전자 연혁

1982~1999	2000~2009	2010~2020	2021~
1982 법인 설립 1983 Gold Bonding Wire 제조기술 특허 취득 및 사업 본격화 1986 Plant 1(용인, HQ) 설립 1997 코스닥 상장	2001 대만법인 설립 Solder Ball 사업 개시 2004 매출 2,000억 원 돌파 1억불 수출 탑 수상 2005 Copper Bonding Wire 사업 개시 2006 2억불 수출 탑 수상 2008 Plant 3(시흥) 준공 3억불 수출 탑 수상 2009 대만시장 점유율 1위 달성 중국법인 설립	2011 6억불 수출 탑 수상 Plant 1(용인, HQ) 신사옥 준공 2016 중국법인 신공장 준공(Capacity 증설) 2018 Plant 2(음성) 준공 Solder Paste 사업 개시 2020 Vision 2025 선포	2022 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영선포 2023 Pd Alloy 사업 개시 2024 UL 인증 획득 2025 Gold Bonding Wire 세계일류상품 선정 Plant 4(인천) 준공 베트남법인 설립 캄퍼스(광천) 준공

자료: 엠케이전자, 한국IR협의회 기업리서치센터

종속회사 현황

1H26말 기준 21개의 연결대상 종속회사 보유

1H26말 기준 엠케이전자는 21개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있다. 사업별로는 반도체 소재를 제조·판매하는 종속회사, 부동산신탁 및 이와 연계된 자산운용·부동산투자 법인, 투자회사, 자원개발 법인, 환경관리 법인으로 구성된다.

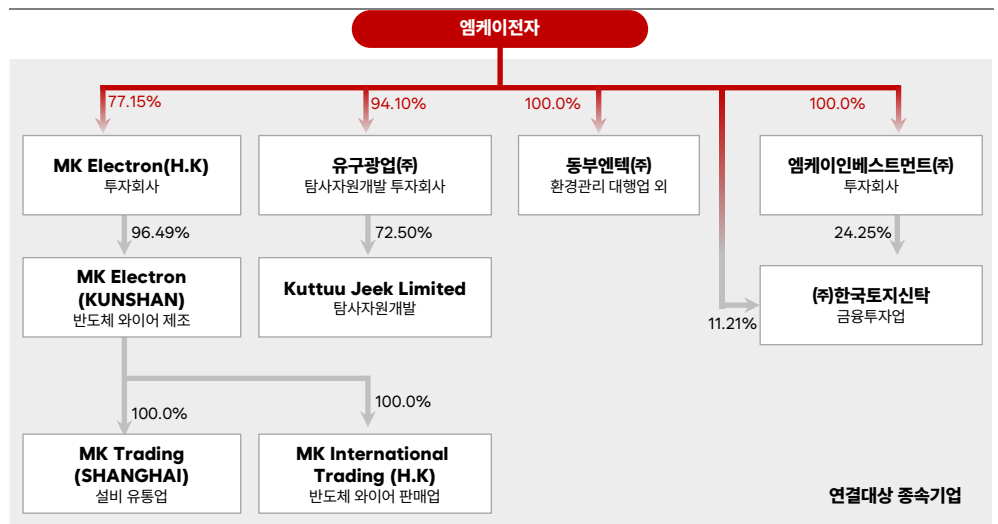
반도체 부문에서는 홍콩 소재 투자회사 MK Electron (H.K)(지분율 77.15%, 자산총액 330억 원)을 두고 있으며, 그 아래로 중국 반도체 와이어 제조법인 MK Electron (KUNSHAN)(지분율 96.49%, 자산총액 2,208억 원)이 있다. MK Electron (KUNSHAN)의 자회사로는 설비 유통 법인 MK Trading (SHANGHAI)(지분율 100.00%, 자산총액 125억 원)과 반도체 와이어 판매법인 MK International Trading (H.K)(지분율 100.00%, 자산총액 없음)이 있다.

투자·부동산 부문에서는 엠케이전자가 투자회사 엠케이인베스트먼트(주)(지분율 100.00%, 자산총액 735억 원)을 두고 있으며, 엠케이전자와 엠케이인베스트먼트가 합산 35.46%를 보유한 부동산신탁 상장기업 (주)한국토지신탁(자산총액 약 1조 7,545억 원)을 실질지배력을 근거로 연결에 포함한다.

한국토지신탁 및 그 자회사가 보유한 하위 법인으로는 집합투자업을 영위하는 코레이트자산운용(주)(지분율 94.74%, 자산총액 275억 원)과 부동산투자·자산관리 법인 11사가 있다.

이 밖에 자원개발 법인 유구광업(주)(지분율 94.10%, 자산총액 6억 원)과 그 자회사 Kuttuu Jeek Limited(지분율 72.50%, 자산총액 없음)는 청산 예정 및 진행 중이며, 환경관리 법인 동부엔텍(주)(지분율 100.00%, 자산총액 457억 원)은 지분 전량 매각 계약 체결에 따라 중단영업으로 분류되어 있다.

엠케이전자 지분도(1H26말 기준)



자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

주1: 지분도에 표시되지 않은 연결대상 종속회사로는 (주)한국토지신탁의 자회사 코레이트자산운용(주), 케이원제8호위탁관리부동산투자회사, 코레이트에스에이치전문투자형사모부동산투자신탁, 코레이트플렉스전문투자형사모부동산투자신탁5호, 코레이트베트남HS일반사모부동산투자신탁, 코레이트여수학동일반사모부동산투자신탁, 코리아에셋리츠전문사모부동산투자신탁, 크레스톤서밋일반사모투자신탁제5호, 코레이트안성전문투자형사모부동산투자신탁, 코레이트춘천GH일반사모부동산투자신탁, 코레이트포천S일반사모부동산투자신탁, 코레이트서산전문투자형사모부동산투자신탁이 있음

주2: 유구광업(주) 및 Kuttuu Jeek Limited는 청산 예정 및 진행 중에 있으며, 동부엔텍(주)는 2026년 6월 지분 전량 매각 계약 체결에 따라 중단영업부문으로 분류

3 주요 사업 및 매출 구성

1H26 기준 매출 비중은 반도체 소재 89.2%, 금융 10.8%로 구성되며 반도체 소재 내 본딩와이어 비중은 91.5%

엠케이전자의 주요 사업은 반도체 소재 및 금융 사업 등이 있다. 1H26 연결 기준 매출 비중은 반도체 소재 89.2%, 금융 10.8%를 기록하였다. 기존 기타 사업에는 환경관리업을 영위하는 동부엔텍 등이 포함됐으나, 2026년 6월 동부엔텍 지분 전량을 매각하면서 2Q26부터 중단영업으로 분류되었다. 금융 및 기타 사업을 제외한 반도체 소재 매출 기준 제품별 비중은 본딩와이어 91.5%, 솔더볼 3.5%, 스퍼터링 타겟 2.3%, 골드 증착재 0.5%, 기타 제품 2.3%를 기록하였다.

본딩와이어(Bonding Wire)

동사의 주력 제품으로 반도체 칩과 패키지 간 전기적 신호 및 전원을 연결하는 미세 금속 소재이다. Gold, Cu, Ag Wire와 Cu Core에 Pd 또는 Au를 도금한 Coated Wire 등을 생산한다. 국내 본사와 중국 쿤산 법인을 생산거점으로 삼성전자, SK하이닉스, ASE, Amkor 등 글로벌 IDM 및 OSAT 업체에 공급하고 있으며, 글로벌 시장점유율 22%로 1위를 기록하고 있다. 한국 및 중국 합산 생산능력은 월 65~70만 km 수준이다. 본딩와이어 산업은 비용 절감 노력과 기술 혁신으로 인해 현재 약 50~60% 구리, 은 소재로 대체되었으며 Automotive, Memory PKG 등에는 여전히 골드와이어가 주로 사용되고 있다.

솔더볼(Solder Ball)

반도체 칩과 기판을 접합해 전기적 신호를 전달하는 구형 접합 소재이다. BGA, CSP, WLCSP, Flip Chip 등 패키징 공정에 사용되며, 패키지 종류에 따라 수십~수백 μm 수준이며, 미세화가 진행되면서 더 작아지는 추세이다. 동사는 일반 솔더볼 외 고신뢰성 및 중저온계 제품과 Cu Core Solder Ball(CCSB) 등을 생산한다. 글로벌 시장점유율은 2020년 10%에서 2024년 15%로 확대돼 글로벌 3위를 기록하고 있다.

솔더페이스트(Solder Paste)

Solder Powder와 Flux를 혼합한 접합 소재로 반도체 패키징 및 기판 실장 공정에 사용된다. 웨이퍼 레벨에서는 미세 범프를 형성하는 접합 소재로 사용되며, SMT(표면실장) 공정에서는 PCB 위에 도포해 기판과 부품의 Lead 및 Pad 간 전기적·기계적 접합을 형성한다. 동사는 자체 Flux 기술을 확보해 Powder $\rightarrow$ Flux $\rightarrow$ Paste 전 공정을 내재화했으며, 미세 피치 대응이 필요한 반도체용 고사양 Paste를 중심으로 사업 확대를 추진 중이다.

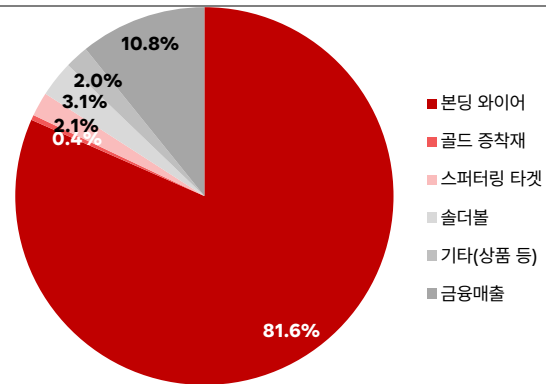
Pd Alloy

Pd, Ag, Cu로 구성된 합금 소재로 반도체 테스트 소켓의 Pogo Pin 중 반도체와 직접 접촉하는 Plunger에 적용된다. 높은 경도와 내마모성 및 균일한 물성을 기반으로 반복적인 테스트 환경에서 접촉 신뢰성과 수명을 확보하는 소재로, 2025년부터 양산을 시작하였다. 회사는 2026년 일본 및 대만 등 해외 고객사 확대를 추진 중이다.

금융

연결 자회사인 한국토지신탁과 코레이트자산운용 등을 통해 부동산신탁, 집합투자 및 부동산 관련 금융사업을 영위한다. 엠케이전자는 엠케이인베스트먼트를 포함해 한국토지신탁 지분 35.46%를 보유하고 있으며 실질 지배력에 따라 연결 종속회사로 반영하고 있다. 1H26 연결 매출의 약 10.8%가 금융사업에서 발생하였다.

엠케이전자 매출 비중



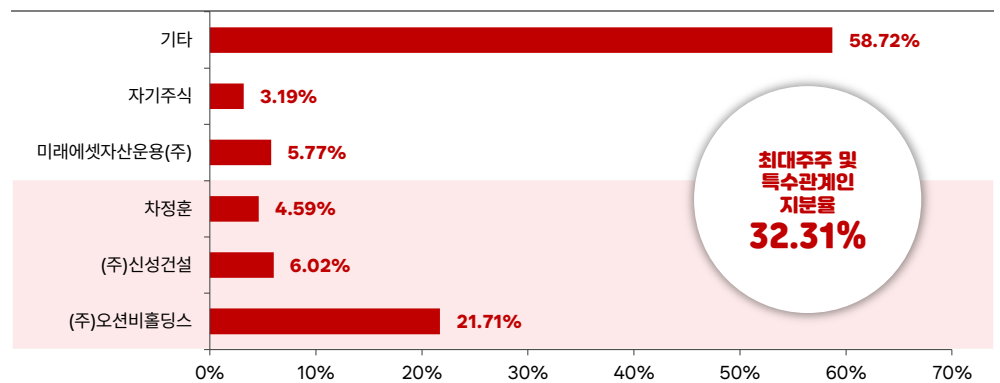
주: 1H26 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

주주 구성

**최대주주는 (주)오션비홀딩스로
지분 21.71% 보유, 최대주주 및
특수관계인 지분을 32.31%**

1H26말 기준 엠케이전자의 최대주주는 (주)오션비홀딩스로 지분 21.71%를 보유하고 있으며, (주)신성건설(6.02%)과 차정훈 기타비상무이사(4.59%)를 포함한 최대주주 및 특수관계인 지분 합계는 32.31%이다. 오션비홀딩스는 차정훈 및 그 특수관계자가 지분 65.57%를 보유한 지주회사이다. 엠케이전자의 대표이사는 전문경영인 현기진이 맡고 있으며, 차정훈 기타비상무이사는 최대주주 측을 대표해 이사회에 참여하고 있다. 최대주주 및 특수관계인 외 5% 이상 주주로는 미래에셋자산운용(주)이 지분 5.77%를 보유하고 있다. 이 밖에 1H26말 기준 자기주식은 772,191주로 발행주식총수의 3.19%이며, 소액주주는 23,101명으로 발행주식총수의 45.18%를 보유하고 있다.

엠케이전자 주주 현황



주: 2026년 6월말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



1 글로벌 반도체 시장 전망

**2026년 글로벌 반도체 시장은
메모리의 성장 주도로 1.67조
달러(+110.9% YoY) 까지 확대될
것으로 예상**

2026년 글로벌 반도체 시장은 AI 인프라 투자 확대와 메모리 업황 호조로 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 2026년 글로벌 반도체 시장 규모는 1.67조 달러(+110.9% YoY), 2027년에는 2.4조 달러(+43.6% YoY)까지 확대될 것으로 예상된다. 특히 메모리 부문은 2026년 전년 대비 +326.8% 성장하며 전체 시장 성장을 주도할 전망이다. AI GPU와 ASIC 등 가속 컴퓨팅 수요가 지속되는 가운데 Server DRAM, HBM, Enterprise SSD 등 고부가 메모리 수요가 동시에 증가하면서 반도체 시장 성장의 중심이 기존 모바일, PC에서 데이터센터와 AI 인프라로 빠르게 이동하고 있다.

AI 인프라 투자는 기존 북미 Hyperscaler 중심에서 국가 및 지역 단위의 Sovereign AI로 확산되고 있다. 북미 빅테크 4사의 CAPEX 컨센서스는 2026년 +80.9% YoY 증가한 데 이어 2027년에도 +37.7% YoY 증가할 것으로 예상되는 등 기존 CSP의 투자 확대가 지속되고 있다. 동시에 데이터 주권, 국가 안보 및 자국 산업 경쟁력 확보를 목적으로 각국 정부와 통신사, 지역 Cloud 사업자의 AI Compute 투자도 빠르게 증가하고 있다. 한국과 일본을 비롯해 유럽, 중동, 인도 등에서 국가 단위 AI Data Center와 AI Cloud 구축이 확대되고 있으며, Sovereign AI에서도 자체적인 AI Compute 인프라 확보가 핵심 축으로 부상하고 있다. 이에 따라 AI 인프라 투자는 북미 Hyperscaler가 주도하는 구조는 유지되는 가운데 Sovereign AI가 새로운 수요 축으로 추가되면서 지역과 투자 주체가 동시에 확대되는 국면으로 진입하고 있다.

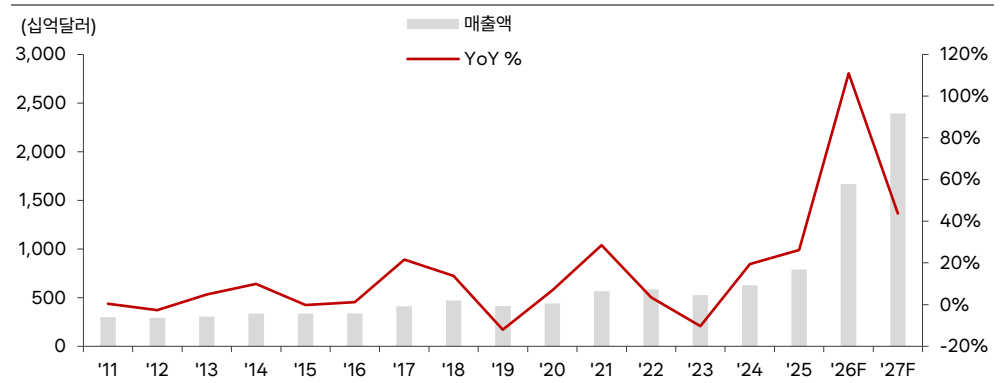
AI Application의 확대는 메모리 수요의 범위도 넓히고 있다. 초기 생성형 AI 투자가 LLM 학습을 위한 GPU와 HBM 중심으로 이루어졌다면, 추론과 Agentic AI가 확산되면서 CPU, Memory, Storage를 포함한 서버 시스템 전반의 성능과 용량 확대가 중요해지고 있다. 이에 따라 HBM뿐 아니라 고용량 RDIMM, LPDDR5X 및 Enterprise SSD 등 다양한 메모리 제품의 수요가 동시에 증가하고 있다. 특히 추론은 학습 대비 보다 광범위한 서비스와 사용자 기반에서 반복적으로 연산이 발생하기 때문에 AI 서버 수요를 확대하는 동시에 CPU 및 시스템 메모리에 대한 수요 증가로 이어질 전망이다. 이에 따라 AI 메모리 Cycle은 HBM 단일 제품의 성장에서 서버 시스템 전반의 메모리 수요 증가로 확산되고 있다.

이번 Cycle에서 보다 주목할 부분은 AI 수요 확대가 글로벌 DRAM 공급업체의 Product Mix와 역할을 동시에 변화시키고 있다는 점이다. 선두 메모리 업체들은 제한적인 생산능력을 HBM, DDR5 및 고용량 Server DRAM 등 고부가 제품에 우선 배분하고 있다. HBM은 일반 DRAM 대비 동일한 Bit 생산에 더 많은 Wafer 투입이 필요하고 신규 Fab 역시 건설과 장비 반입, Ramp-up까지 상당한 시간이 소요되는 만큼 전체 DRAM 공급이 단기간에 크게 증가하기는 어려운 구조다. 이에 따라 고부가 제품으로 CAPA가 이동할수록 DDR4, DDR3 등 Mature DRAM의 공급 여력은 상대적으로 축소되고, 선두 업체의 범용 메모리 공급 여력 역시 제한되고 있다.

이러한 공급구조 변화와 함께 중국 메모리 업체의 역할도 확대되고 있다. 중국 DRAM 업체들은 DDR 및 LPDDR을 중심으로 생산능력을 확대하면서 범용 메모리 시장에서 공급 비중을 높이고 있으며, 선두 업체들과 제품 Portfolio가 점차 분화되는 모습이다. 향후 DRAM 시장은 선두 업체가 HBM과 선단 Server DRAM 등 고부가 제품에 집중하는 한편 중국 업체의 범용 DDR 및 LPDDR 공급 비중이 확대되면서 제품별 공급업체의 역할 분화가 더욱 지속될 전망이다. AI 수요 확대에 따라 제품별 CAPA 배분과 글로벌 메모리 공급구조의 변화도 이어질 것으로 예상된다.

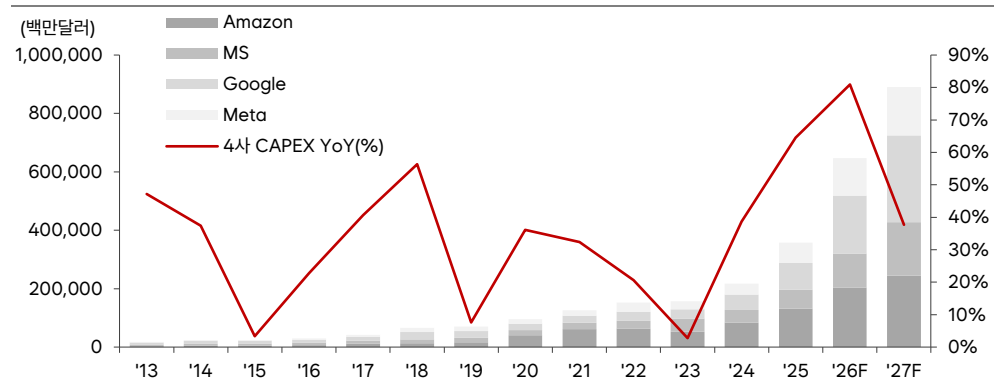
NAND 역시 AI 인프라 확대에 따른 고용량 Enterprise SSD 수요가 성장을 견인하고 있다. 생성형 AI와 Agentic AI 확산으로 데이터 생성량과 저장 수요가 증가하면서 주요 공급업체들은 Consumer 제품보다 TLC 및 QLC 기반의 고용량 Enterprise SSD 중심으로 Product Mix를 전환하고 있다. 다만 DRAM과 달리 NAND는 고단화 전환을 통한 Bit Density 증가가 공급 확대에 보다 직접적으로 기여할 수 있어 중장기 수급 구조에는 차이가 존재한다. Enterprise SSD 중심의 수요 성장은 지속될 전망이다. 신규 CAPA와 고단화 효과가 본격화될 경우 공급 증가율도 함께 높아질 수 있어, NAND의 공급 부족은 DRAM보다 먼저 완화될 가능성이 높다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이



자료: WSTS, Trendforce, 한국IR협회의 기업리서치센터

북미 Big Tech 연간 CAPEX 추이



자료: Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 후공정 및 패키징 시장 전망

AI-HPC 확산과 미세화 한계로 후공정-어드밴스드 패키징의 중요성 확대

AI 및 HPC 확산과 반도체 미세화 한계로 반도체 산업에서 후공정과 패키징의 중요성이 높아지고 있다. 과거 패키징이 반도체 칩을 보호하고 기판과 연결하는 역할에 집중됐다면, 최근에는 서로 다른 기능의 Chip을 하나의 Package 안에 집적해 시스템 성능과 전력 효율을 높이는 방향으로 역할이 확대되고 있다. 이에 따라 2.5D/3D, Chiplet, HBM, Fan-out, Hybrid Bonding 등 Advanced Packaging 기술의 적용이 빠르게 증가하고 있다. 글로벌 Advanced Packaging 시장은 2025년 약 550억 달러에서 2031년 1,200억 달러 이상으로 성장할 전망이다. AI Accelerator와 HPC가 시장 성장을 주도할 것으로 예상된다.

Advanced Packaging에서는 Logic과 Memory 간 데이터 이동량이 증가하면서 Package 내부의 연결 밀도와 I/O 수가 빠르게 증가하고 있다. AI GPU와 ASIC은 HBM을 함께 탑재하기 위해 Silicon Interposer와 2.5D Packaging을 활용하고 있으며, 향후에는 Chiplet과 3D 적층을 통해 Logic, Memory, I/O 등 서로 다른 기능의 Die를 하나의 Package에 통합하는 구조가 확대될 전망이다. 이에 따라 미세 Bump, TSV, TCB, Hybrid Bonding 등 고밀도 접합 기술의 적용이 늘어나고 있으며, Package 대형화와 고집적화에 대응하기 위한 기판, 접합 소재 및 방열 기술의 중요성도 함께 높아지고 있다. 후공정 장비 시장에서도 TCB와 Hybrid Bonding 장비가 기존 Die Bonder보다 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다.

다만 Advanced Packaging의 확대가 기존 Wire Bonding 중심의 패키징을 일괄적으로 대체하는 구조는 아니다. 반도체는 제품의 성능, 가격, 신뢰성 및 생산량에 따라 서로 다른 패키징 기술이 적용되며, Automotive, Analog, MCU, Power Semiconductor 및 범용 Memory 등에서는 가격 경쟁력과 높은 양산 안정성을 보유한 Wire Bonding 기반 Package가 여전히 광범위하게 사용되고 있다. 특히 차량용 반도체는 긴 제품 수명과 높은 신뢰성이 요구되기 때문에 검증된 Leadframe 및 Wire Bonding Package의 활용도가 높으며, Memory에서도 Stacked CSP와 BGA 등 Wire Bonding을 활용하는 패키지 구조가 지속적으로 사용되고 있다. 이에 따라 향후 후공정 시장은 Advanced Packaging이 높은 성장률을 기록하는 가운데 기존 패키징 기술 역시 적용처별 수요를 유지하는 형태로 성장할 전망이다.

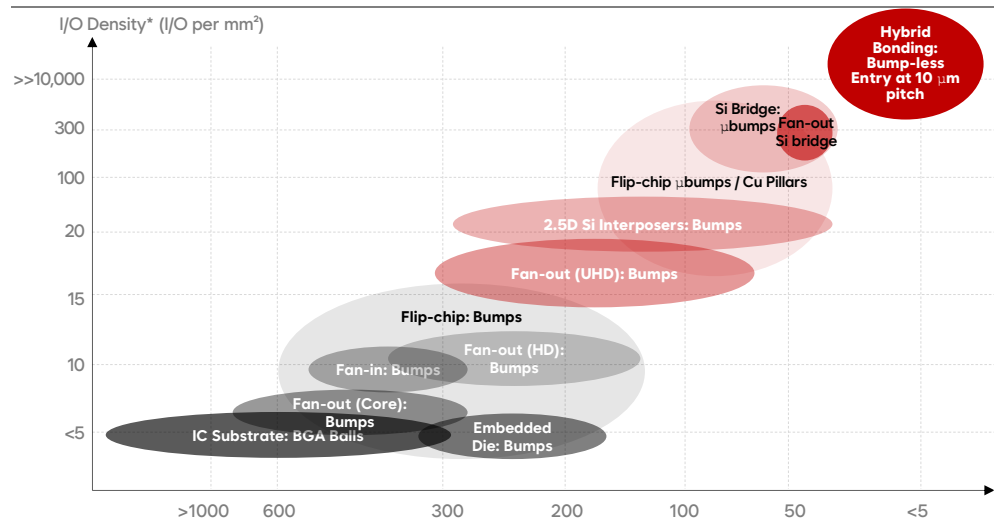
Memory Packaging에서는 고용량화에 대응하기 위한 Die Stacking과 Package 집적도 증가가 지속되고 있다. NAND는 하나의 Package 안에 다수의 NAND Die와 Controller를 집적하는 구조가 보편화되고 있으며, 고용량 제품에서는 20개 이상의 Die를 적층하는 Package도 적용되고 있다. DRAM과 LPDDR 역시 모바일뿐 아니라 서버와 AI 인프라로 적용처가 확대되면서 낮은 전력소모와 높은 대역폭, 제한된 면적에서 더 많은 용량을 구현하기 위한 Package 기술이 중요해지고 있다. 이 과정에서 Stacked Die를 Package Substrate와 연결하는 Wire Bonding과 Package를 기판에 접합하는 Solder Ball 등 기존 접합 기술도 고용량화와 미세화에 맞춰 지속적으로 발전하고 있다.

특히 AI 서버에서는 기존 DDR 계열 DIMM과 함께 LPDDR 기반의 새로운 Memory Form Factor가 등장하고 있다. SoCAMP2는 LPDDR5X의 낮은 전력소모와 높은 대역폭을 서버에 적용하면서도 교체가 가능한 모듈 구조를 채택하고 있으며, 차세대 AI CPU 플랫폼에서 적용이 본격화되고 있다. 고용량 SoCAMP2는 제한된 Module 면적에서 용량을 확대하기 위해 하나의 LPDDR Package 내부에 다수의 DRAM Die를 적층하는 구조를 활용한다. 이에 따라 AI 서

버의 Memory Architecture 역시 HBM 중심에서 HBM과 고용량 LPDDR, RDIMM 등 다양한 Form Factor가 병존하는 방향으로 확대되고 있으며, 각 Memory Package 내부의 집적도와 후공정 난이도도 함께 상승할 전망이다.

후공정 소재 역시 패키지 미세화와 원가 절감 요구에 대응해 변화하고 있다. Wire Bonding은 기존 Gold Wire 중심에서 Cu, Ag 및 Coated Wire 등으로 소재가 다변화되고 있으며, 제품 특성과 요구 신뢰성에 따라 소재별 적용 영역이 분화되고 있다. Solder Ball 역시 Package의 I/O 증가와 Pitch 축소에 대응해 미세화가 진행되는 가운데 고신뢰성, 저온 접합 및 미세 Pitch 대응이 중요해지고 있다. 한편 초미세 Interconnect에서는 Flip Chip, TCB, Hybrid Bonding 등의 적용이 확대되고 있어 향후 후공정 시장은 하나의 접합 기술로 통합되기보다 Package 성능과 원가, 신뢰성에 따라 다양한 Interconnect 기술과 소재가 병존하는 구조가 지속될 전망이다.

어드밴스드 패키징 기술 로드맵

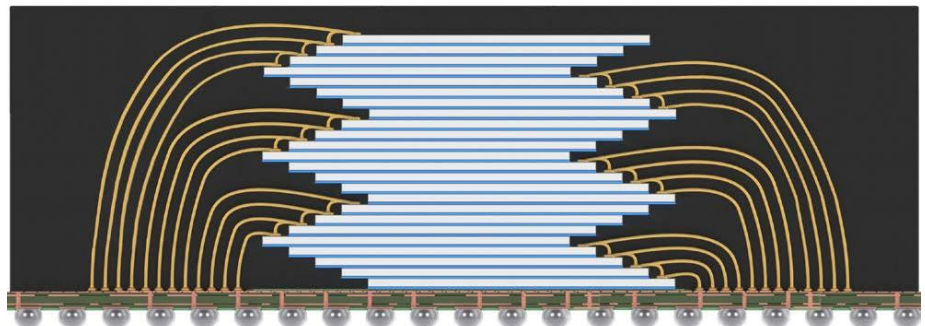


※ I/O Density refers to total number of I/Os per package platform area.
Plot is generated based on Yole Group database, with reference to industry average value.

자료: Yole, 한국IR협회의 기업리서치센터

고적층 메모리 패키지 구조

Stacked CSP Cross Section 24 + 0 Die 3D Memory



자료: Amkor, 한국IR협회의 기업리서치센터



투자포인트

SoCAMP2 도입에 따른 본딩와이어 수요 증가

Vera Rubin부터 SoCAMP2 채택이 본격화되며 모듈당 본딩와이어 사용량 증가 전망

Vera Rubin부터 SoCAMP2 채택이 본격화되면서 동사의 본딩와이어 수요가 확대될 전망이다. SoCAMP(Small Outline Compression Attached Memory Module)은 LPDDR의 저전력, 고대역폭 특성과 서버용 메모리의 교체 가능성을 결합한 메모리 모듈이다. 기존 서버용 DDR5 RDIMM은 용량 확장과 교체가 용이하지만 전력 소모와 모듈 면적 이 큰 반면, LPDDR은 전력 효율과 대역폭 측면에서 유리하나 메인보드에 직접 실장되는 On-board 방식으로 사용돼 교체 및 용량 확장이 어렵다는 한계가 있었다. SoCAMP2는 LPDDR5X를 소형 모듈에 탑재하고 Compression Connector를 통해 메인보드와 연결하는 구조로 이를 보완했다. 수평 장착 방식으로 공간 활용도와 냉각 효율을 높이는 동시에 모듈 교체도 가능하다. Vera CPU는 SoCAMP2 기반 LPDDR5X를 통해 최대 1.2TB/s의 메모리 대역폭과 최대 1.5TB의 메모리 용량을 지원한다.

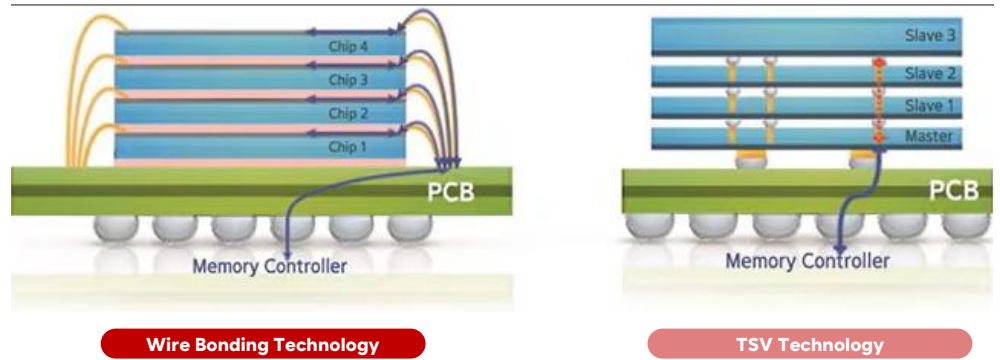
SoCAMP은 당초 GB300에 1세대 제품 적용이 추진됐으나 신뢰성 및 발열 등 기술적 문제로 채택이 취소되었으며 이후 사양을 개선한 SoCAMP2로 전환돼 Vera Rubin부터 본격 적용된다. Vera Rubin에서 Rubin GPU에는 HBM4가 적용되는 반면 Vera CPU의 시스템 메모리에는 LPDDR5X 기반 SoCAMP2가 사용된다. AI 추론 과정에서 CPU가 담당하는 데이터 처리와 KV Cache 관리 부담이 증가하면서 시스템 메모리의 대역폭과 전력 효율 중요성도 높아지고 있어, SoCAMP2는 기존 DDR5 RDIMM 대비 고대역폭, 저전력 특성을 기반으로 AI 서버용 시스템 메모리의 새로운 폼팩터로 채택이 확대될 전망이다.

LPDDR5X의 고적층 패키지 구조로 인해 SoCAMP2 채택이 본딩와이어 수요 증가로 이어진다. 본딩와이어는 SoCAMP2 기판 위에 탑재되는 각 LPDDR5X 패키지 내부에서 적층된 DRAM Die와 패키지 기판을 전기적으로 연결하는 데 사용된다. LPDDR5X는 제한된 모듈 면적에서 대용량을 구현하기 위해 하나의 패키지에 다수의 DRAM Die를 적층하는 구조가 적용된다. 예를 들어 고용량 제품인 Micron의 256GB SoCAMP2는 32Gb LPDDR5X Die 총 64개를 사용하며, 4개의 LPDDR 패키지에 각각 16개의 Die를 적층하는 구조다. 즉 하나의 모듈에 다수의 DRAM Die가 집적되고 각 Die의 Edge Bond Pad와 패키지 기판을 연결하기 위한 Wire Bonding이 반복적으로 적용돼 모듈당 본딩와이어 사용량이 증가하는 구조다.

HBM이 TSV를 통해 적층된 DRAM Die를 수직 연결하는 것과 달리, LPDDR5X는 상대적으로 낮은 I/O 밀도와 원가 효율을 기반으로 다수의 얇은 DRAM Die를 적층한 뒤 Wire Bonding을 통해 패키지 기판과 연결하는 구조가 적용된다. 따라서 SoCAMP2 수요 확대는 단순히 LPDDR Bit 수요 증가뿐 아니라 고적층 LPDDR 패키지 증가 → 적층 Die 수 증가 → Wire Bonding 공정 증가 → 본딩와이어 사용량 증가로 이어진다. 특히 SoCAMP2는 서버용 메모리 시장에서 기존 모바일 LPDDR 대비 고용량, 고적층 패키지를 대량으로 채택한다는 점에서 본딩와이어 산업의 신규 수요처로 작용할 전망이다.

동사는 국내 메모리 고객사의 SoCAMP용 본딩와이어 메인 공급사로 선정된 것으로 파악되며, 2027년부터 고객사의 SoCAMP2 물량 증가에 따른 수혜가 본격화될 전망이다. Vera Rubin을 시작으로 AI 서버에서 LPDDR 기반 시스템 메모리 채택이 확대될 경우 기존 레거시 메모리 패키징 중심이었던 본딩와이어 수요에 새로운 성장 동력이 추가될 것으로 예상된다. 특히 Vera CPU가 Vera Rubin뿐 아니라 독립형 CPU 서버로도 확대될 경우 SoCAMP2 적용처가 확대되면서 중장기 본딩와이어 수요 증가가 이어질 전망이다.

Wire Bonding과 TSV 비교



자료: 삼성전자, 한국R협회의 기업리서치센터

DRAM 업체별 SoCAMP2 개발 현황

구분	삼성전자	SK하이닉스	Micron
현재 용량	192GB	192GB	256GB (최대)
공정	LPDDR5X, 1b nm	LPDDR5X, 1c nm	LPDDR5X, 1γ nm
진행 상황	고객 샘플링(2025년 말), 192GB 양산 시작	2026년 4월 양산	2026년 3월 고객 샘플링
성능	RDIMM 대비 대역폭 2배 이상, 전력 55% 이상 절감	RDIMM 대비 대역폭 2배 이상, 에너지 효율 75% 이상 개선	RDIMM 대비 전력 1/3, 크기 1/3, 모듈당 용량 1.33배
주요 특징	NVIDIA Rubin SoCAMP2 공급의 약 50% 확보 가능성	최첨단 1c DRAM 적용	2025년 3월 SoCAMP1 최초 양산 공급사였으나 출시 지연 발생
잠재 고객	NVIDIA, AMD, Qualcomm, CSP	NVIDIA, AMD, Qualcomm, CSP	NVIDIA, AMD, Qualcomm, CSP

자료: Trendforce, 한국R협회의 기업리서치센터

중국 레거시 메모리 성장으로 본딩와이어 수요 증가 기대

**CXMT·YMTC의 CAPA 확대로
중국법인 수요처가 메모리향
Gold Wire까지 확대 기대**

중국 메모리 업체들의 CAPA 확대에 따라 동사 중국법인의 본딩와이어 수요가 증가할 전망이다. 지금까지 중국법인의 본딩와이어 수요는 메모리보다 중국 시스템반도체 및 OSAT향 Coated Wire 중심이었으며, 중국법인은 동사 반도체 향 매출의 약 27%를 차지한다. 중국 시스템반도체 패키징에서는 원가 경쟁력이 높은 Cu Core 기반 Pd 또는 Au Coated Wire 사용 비중이 높으며, 이에 따라 중국법인은 Gold Wire 비중이 높은 국내 본사와 차별화된 제품 믹스를 보유하고 있다. 향후 중국 메모리 생산능력 확대가 본격화될 경우 기존 시스템반도체향 Coated Wire에 메모리향 Gold Wire 수요가 추가되면서 중국법인의 성장 동력이 확대될 전망이다.

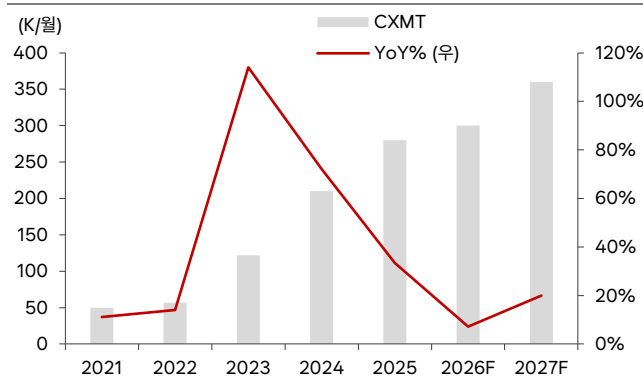
CXMT와 YMTC를 중심으로 중국 메모리 CAPA 확대가 지속될 전망이다. CXMT는 2026년 7월 상하이 STAR Market에 상장했으며 IPO를 통해 약 579억 위안을 조달했다. 조달 자금은 생산능력 확대와 R&D, 운영자금 등에 활용될 예정이다. CXMT는 허페이와 베이징 생산거점을 기반으로 신규 Fab 투자를 확대하고 있으며, DRAM 생산능력은 2026년 300K/월에서 2027년 360K/월로 약 20% 증가할 전망이다. 특히 CXMT는 DDR 및 LPDDR 등 범용 DRAM 비중이 높아 생산능력 확대가 Wire Bonding 기반 패키징 수요 증가와 직접적으로 연결될 가능성이 높다.

NAND에서도 YMTC의 증설이 이어질 전망이다. YMTC의 모회사 CCSH는 2026년 8월 상하이 STAR Market 상장을 신청했으며 약 330억 위안의 자금 조달을 계획하고 있다. 조달 자금은 생산라인 업그레이드와 R&D 등에 활용될 예정이다. YMTC는 신규 생산시설 가동과 공정 전환을 통해 생산능력 확대를 지속하고 있으며, 이에 따라 글로벌 NAND 시장 내 점유율도 상승할 전망이다. YMTC의 NAND 생산능력은 2026년 200K/월에서 2027년 250K/월로 약 25% 증가할 전망이다. CXMT와 YMTC의 생산능력 확대는 웨이퍼 투입량 증가뿐 아니라 패키징 및 테스트 물량 증가로 이어져 중국 OSAT향 본딩와이어 수요 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.

중국 메모리 업체들의 증설은 글로벌 메모리 생산구조 변화와도 맞물릴 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM, SoCAMP 등 고부가 메모리 생산 비중을 확대하면서 제한적인 Fab CAPA 내 레거시 메모리 생산 비중은 점진적으로 감소할 가능성이 높다. CXMT는 중국 내 모바일 DRAM과 범용 DRAM 수요를 기반으로 LPDDR4X, LPDDR5X 및 DDR5 생산 확대를 추진하고 있으며, 한국과 미국 메모리 업체들의 레거시 제품 생산 축소로 발생한 공급 공백을 흡수하고 있다. 이에 따라 글로벌 레거시 메모리 생산의 일부가 중국 업체로 이동하는 흐름이 지속될 것으로 예상되며, 이는 기존 시스템반도체향 Coated Wire 중심이었던 동사 중국법인의 수요처가 메모리용 Gold Wire까지 확대되는 계기가 될 전망이다.

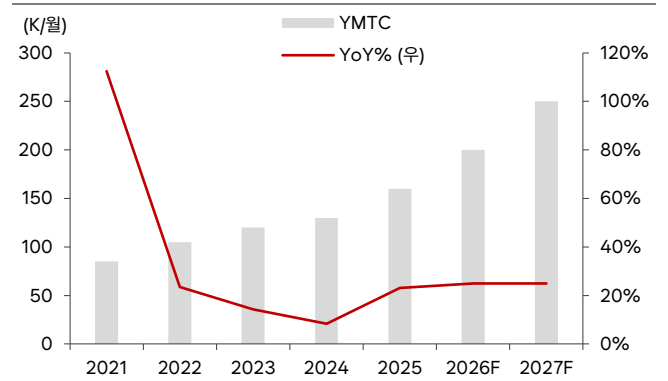
동사는 중국 메모리 수요 확대에 대응해 중국법인의 Gold Wire 생산 확대와 추가 CAPA 투자를 검토하고 있다. 현재 중국법인은 중국 OSAT향 Coated Wire 생산 비중이 높으나 향후 중국 메모리 업체들의 생산량 증가에 대응해 Gold Wire 생산을 확대할 계획이다. 중국 로컬 본딩와이어 업체도 존재하지만 품질과 수율 안정성이 중요한 반도체 후공정 특성상 주요 중국 OSAT는 검증된 선도 업체 제품을 높은 비중으로 사용하고 있는 것으로 파악된다. 동사는 이미 중국 내 생산거점과 고객 기반을 확보하고 있으며 향후 수요 증가에 따라 추가 증설도 검토 중이다. 기존 시스템반도체향 Coated Wire 성장에 메모리향 Gold Wire 수요가 추가되면서 중국법인의 제품 포트폴리오와 성장 기반이 동시에 확대될 전망이다.

CXMT DRAM CAPA 추이



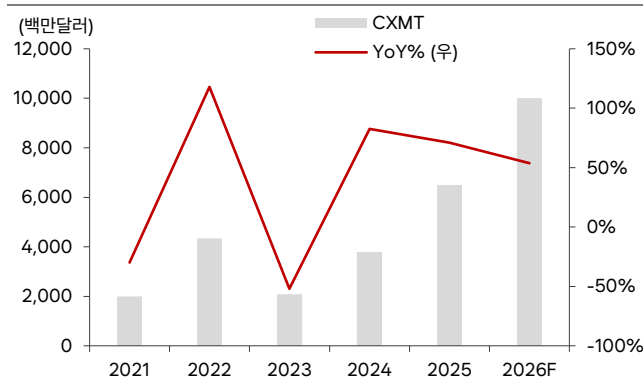
자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

YMTC NAND CAPA 추이



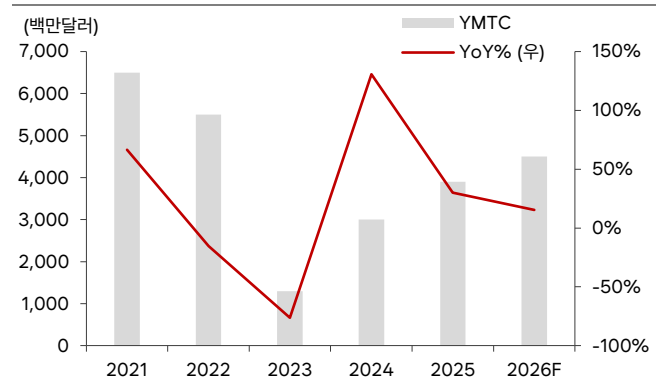
자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

CXMT DRAM CAPEX 추이



자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

YMTC NAND CAPEX 추이



자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 Pd Alloy, 고마진 신사업의 실적 기여 확대

Pd Alloy가 높은 수익성을 기반으로 이익 믹스 개선에 기여

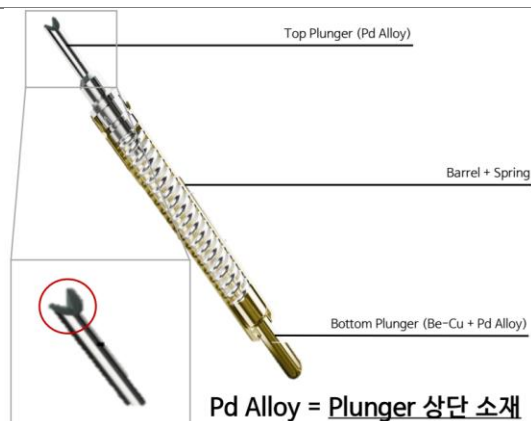
Pd Alloy는 2025년 양산을 시작한 이후 빠르게 매출이 확대되고 있으며, 높은 수익성을 기반으로 동사의 이익 믹스 개선에 기여할 전망이다. Pd Alloy는 Pd, Ag, Cu로 구성된 합금 소재로 반도체 테스트 소켓의 Pogo Pin 중 반도체와 직접 접촉하는 Top Plunger에 적용된다. 동사는 귀금속 소재 가공과 와이어 제조 기술을 기반으로 Pd Alloy 소재 국산화에 성공하였다.

Pogo Pin은 반도체 테스트 과정에서 Device와 Test Board 사이의 전기적 신호를 전달하는 핵심 부품으로, Top Plunger는 반도체 Pad와 직접 접촉해 전기적 신호를 전달하는 역할을 한다. 반복적인 Contact 과정에서 마모나 변형이 발생할 경우 접촉저항 증가와 테스트 신뢰성 저하로 이어질 수 있어 소재의 경도와 내마모성이 중요하다. 동사의 Pd Alloy는 Pd, Ag, Cu 조성을 기반으로 높은 경도와 균일한 와이어 조직을 구현하며, 제품별 열처리를 통해 경도를 조절할 수 있다. 기존 제품 대비 사용 수명을 개선한 신규 제품도 개발 중이다.

2025년 약 22억 원의 매출액을 기록한 Pd Alloy는 2026년 들어 매출 성장이 본격화되고 있다. 월 매출액은 약 13~14억 원 수준으로, 2026년 연간 매출액은 약 150억 원을 기록할 전망이다. 수익성 측면에서도 기존 사업 대비 높은 이익 기여가 기대된다. Pd Alloy의 이익률은 약 25~30% 수준으로, 본딩와이어와 솔더볼을 상회한다. 본딩와이어는 귀금속 원재료 비중이 높아 원재료 가격이 판가에 연동되는 구조인 반면, Pd Alloy는 소재 조성 및 가공 기술을 기반으로 상대적으로 높은 부가가치를 확보할 수 있다. 아직 매출 비중은 낮지만 외형 성장과 높은 수익성을 감안하면 이익 기여도는 매출 성장보다 빠르게 확대될 전망이다.

향후 고객사 확대도 추가 성장 요인이다. 현재 국내 고객사를 중심으로 양산 공급 중이며 일본과 대만 등 해외 고객사를 대상으로 제품 평가 및 프로모션을 진행하고 있다. 해외 고객사 공급이 확대될 경우 추가적인 외형 성장이 가능할 전망이다. 높은 수익성을 감안하면 Pd Alloy는 향후 동사의 이익 성장을 견인하는 주요 신사업으로 자리잡을 전망이다.

Pd Alloy



자료: 엠케이전자, 한국IR협회의 기업리서치센터



실적 추이 및 전망

본업 성장에도 자회사 부진으로 수익성 부진했던 2025년

2025년 매출액 1조 4,038억 원(+19.9% YoY), 영업이익 142억 원(-74.7% YoY) 기록

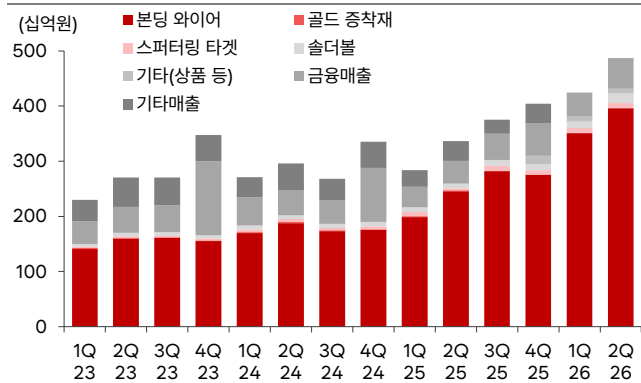
2025년 동사의 연결 매출액은 1조 4,038억 원(+19.9% YoY), 영업이익은 142억 원(-74.7% YoY)을 기록하였다. 반도체 소재 중심의 제조업 부문은 매출액 1조 926억 원(+43.5% YoY), 영업이익 306억 원(+41.5% YoY)을 기록하며 양호한 성장세를 보였다. 반면 금융 부문은 매출액 1,844억 원(-22.0% YoY), 영업손실 209억 원을 기록하며 전년 영업이익 339억 원에서 적자전환하였다. 환경관리 부문은 매출액 1,269억 원(-26.6% YoY), 영업이익 45억 원을 기록하였다.

제조업 부문에서는 주력 제품인 본딩와이어가 외형 성장을 견인하였다. 2025년 본딩와이어 매출액은 1조 21억 원(+41.9% YoY)을 기록했으며, 솔더볼은 370억 원(+31.7% YoY), 스퍼터링 타겟은 280억 원(+42.9% YoY), 골드 증착재는 65억 원(+6.7% YoY), 기타 제품은 191억 원을 기록하였다. 기타 제품에는 솔더바, 솔더페이스트, 솔더파우더 및 테스트 소재 등이 포함되며, 2025년 양산을 시작한 Pd Alloy의 매출도 신규로 반영되었다. 본딩와이어 매출 증가는 고객사 생산 증가에 따른 물량 확대와 금 가격 상승에 따른 판가 상승 영향에 기인한다. 2025년 본딩와이어 평균 판매가격은 내수 기준 74.1만 원/km로 전년 대비 +46.8%, 수출은 80.7만 원/km로 +40.3% 상승하였다. 같은 기간 주요 원재료인 금 평균 매입가격도 \$2,374.6/T.oz에서 \$3,472.5/T.oz로 +46.2% 상승하였다. 본딩와이어는 금 가격 변동분이 판가에 연동되는 구조인 만큼 매출 성장에는 원재료 가격 상승에 따른 ASP 상승 효과가 크게 반영되었다. 이와 함께 중국 시스템반도체 및 OSAT형 Coated Wire 수요 증가도 제조업 외형 성장에 기여하였다. 솔더볼은 고객사 수요 증가에 힘입어 매출액이 전년 대비 +31.7% 증가했으나 원재료 가격 상승분의 판가 반영이 지연되면서 수익성 개선은 제한적이었다. Pd Alloy는 2025년 양산을 시작해 약 22억 원의 매출액을 기록하였다.

금융 부문은 부동산 경기 부진에 따른 한국토지신탁의 실적 악화 영향으로 적자전환하였다. 과거 신규 수주 감소 영향으로 신탁사업 관련 매출이 감소한 가운데 프로젝트 관련 비용과 총당금 부담이 지속되면서 영업손실 209억 원을 기록하였다.

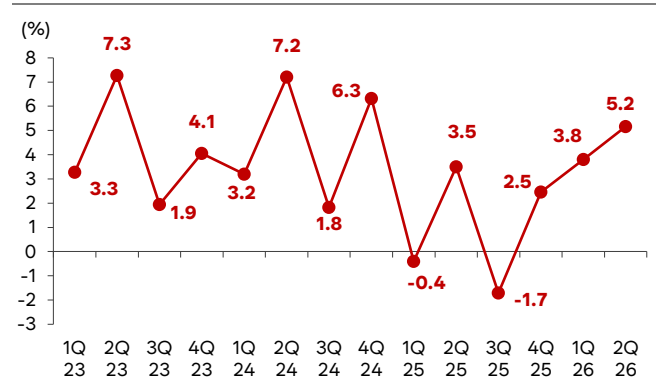
수익성 측면에서는 연결 OPM이 1.0%로 전년 4.8% 대비 3.8%p 하락하였다. 제조업 부문은 본딩와이어 및 증착법인의 외형 성장과 제품 믹스 개선에 힘입어 영업이익이 증가했으나, 금융 부문이 전년 339억 원의 영업이익에서 209억 원의 영업손실로 적자전환하면서 연결 수익성 하락의 주요 원인으로 작용하였다.

엠케이전자 부문별 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

엠케이전자 분기별 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 소재 성장으로 실적 개선 지속

2026년 매출액

1조 9,842억 원(+41.3% YoY),

영업이익

1,090억 원(+668.5% YoY)

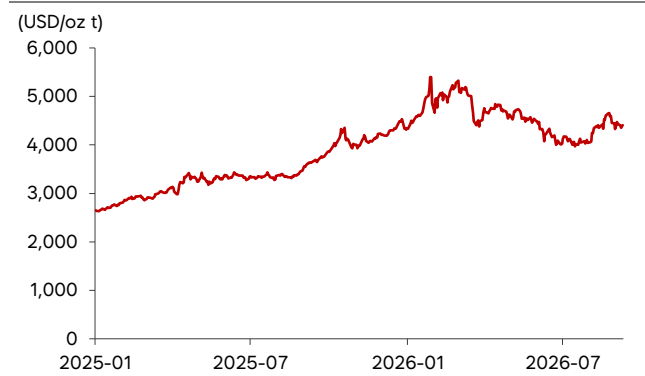
전망

2026년 동사의 매출액은 1조 9,842억 원(+41.3% YoY), 영업이익은 1,090억 원(+668.5% YoY)을 전망한다. 1H26 연결 매출액은 9,155억 원(+47.7% YoY), 영업이익은 415억 원(+290.4% YoY)을 기록하였다. 2Q26 한국 및 중국법인 합산 반도체 소재 매출액은 4,383억 원, 영업이익은 211억 원을 기록했으며, 국내 본사와 중국법인 모두 전분기 대비 매출액과 영업이익이 증가하였다. 한편 환경관리업을 영위하던 동부엔텍은 2026년 6월 지분 전량을 매각함에 따라 2Q26부터 중단영업으로 분류되었으며, 2026년 실적 추정에서는 제외하였다.

2026년 본딩와이어 매출액은 1조 6,244억 원(+62.1% YoY)을 전망한다. 상반기에는 주요 고객사의 반도체 생산 증가와 중국 시스템반도체 및 OSAT형 Coated Wire 수요 확대가 지속된 가운데, 금 가격 상승에 따른 ASP 상승 효과가 외형 성장을 견인하였다. 하반기에도 본딩와이어 출하량은 견조한 수준을 유지할 전망이다. 3Q26은 금 가격과 환율 하락에 따른 판가 조정 영향으로 2Q26 대비 매출액이 유사하거나 소폭 감소할 것으로 보이나 이는 수요 감소보다는 원재료 가격 연동에 따른 ASP 영향이 크다. 4Q26에는 고객사 생산량 증가에 따라 물량 성장이 재차 확대될 것으로 예상된다.

솔더볼 매출액은 620억 원(+67.7% YoY)을 전망한다. 고객사 수요 증가가 지속되는 가운데 3Q25부터 진행된 원재료 가격의 판가 연동 효과가 2026년부터 본격적으로 반영되고 있다. 2Q26 솔더볼 매출액은 전분기 대비 약 52% 증가하며 성장세가 가속화되었고, 연간 수익성도 전년 대비 개선될 것으로 전망한다. 골드 증착재와 스퍼터링 타겟 매출액은 각각 85억 원(+30.1% YoY), 410억 원(+46.7% YoY)을 전망한다. 기타 제품 매출액은 485억 원(+154.6% YoY)으로 예상하며, 2025년 양산을 시작한 Pd Alloy의 매출액이 약 150억 원 수준까지 확대되면서 성장을 견인할 것으로 전망한다.

금 가격 추이



자료: Investing.com, 한국IR협회의 기업리서치센터

은 가격 추이

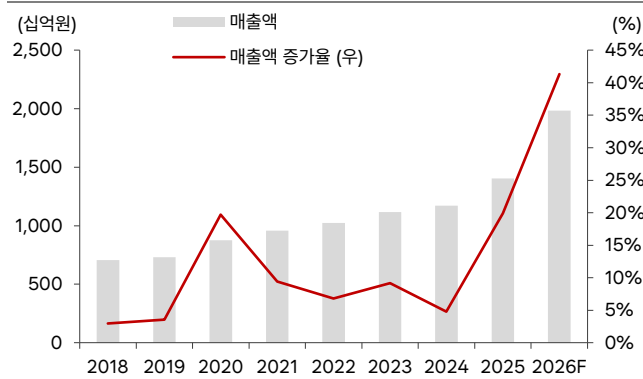


자료: Investing.com, 한국IR협회의 기업리서치센터

금융 부문 매출액은 1,998억 원(+8.4% YoY)을 전망한다. 한국토지신탁은 2023~2024년 신규 수주 부진의 영향으로 신탁보수 매출 기반이 약화된 가운데, 일부 사업장 관련 대손 및 총당금 부담이 더해지며 2025년 영업적자를 기록하였다. 다만 2025년부터 신규 수주가 회복되면서 신규 사업장의 매출 기여가 확대되고 신탁보수 수익이 증가하는 가운데, 전년의 대손 및 총당금 부담도 완화돼 1H26 영업이익은 49억 원으로 전년 동기 적자에서 흑자 전환하였다. 하반기에도 2025년 수주 회복분의 매출 인식이 본격화되면서 금융 부문의 외형 및 수익성 개선이 이어질 것으로 예상된다.

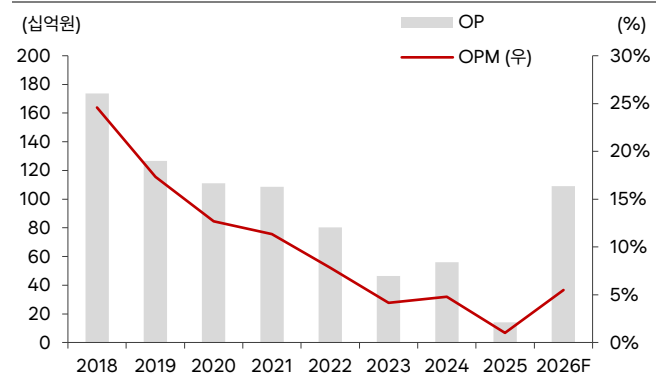
수익성 측면에서는 연결 OPM이 5.5%로 전년 1.0% 대비 4.5%p 상승할 것으로 전망한다. 반도체 소재 부문의 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화, 솔더볼의 원재료 가격 평가 반영에 따른 수익성 개선, 높은 수익성을 보유한 Pd Alloy의 매출 확대가 제조업 부문의 이익 개선을 견인할 것으로 예상된다. 여기에 2025년 영업손실을 기록했던 금융 부문의 실적 회복이 더해지면서 연결 기준 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망한다.

엠케이전자 매출액 및 매출액 증가율 추이



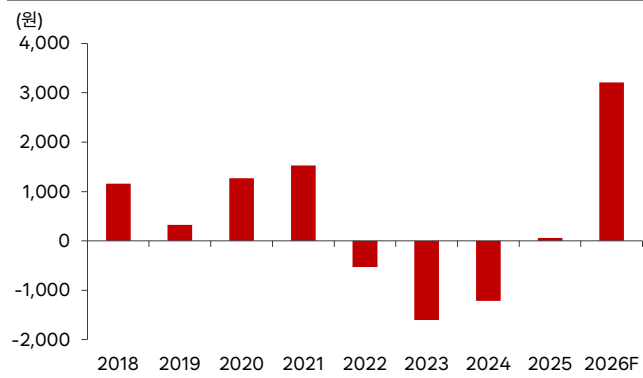
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

엠케이전자 영업이익 및 영업이익률 추이



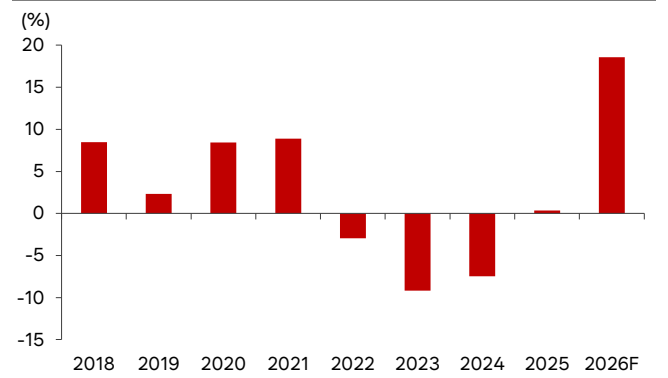
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

엠케이전자 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

엠케이전자 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

엠케이전자 부문별 실적

(단위: 십억 원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025	2026F
매출액	228.4	270.7	274.1	343.8	272.0	295.1	267.9	335.5	283.7	336.1	376.9	407.1	426.5	489.0	1,170.6	1,403.8	1,984.2
분당 와이어	140.9	160.0	161.0	155.1	169.8	187.9	172.9	175.4	198.6	245.5	282.3	275.6	350.7	396.4	706.1	1,002.1	1,624.4
골드 증착재	1.0	1.5	1.2	1.0	2.3	1.3	1.2	1.4	1.5	1.9	1.8	1.4	1.9	2.1	6.1	6.5	8.5
스퍼터링 타겟	1.6	2.6	2.5	3.5	4.6	5.4	4.5	5.0	7.2	3.1	9.6	8.1	9.8	9.1	19.6	28.0	41.0
솔더볼	4.8	5.7	6.4	5.2	7.0	6.7	6.8	7.6	8.2	8.3	10.0	10.4	11.2	17.0	28.1	37.0	62.0
기타(상품 등)	0.3	0.6	4.2	-2.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	17.3	9.2	9.1	1.7	19.1	48.5
금융	41.3	47.0	48.1	133.7	51.3	44.5	42.3	98.2	37.2	41.2	47.5	58.4	43.7	55.2	236.3	184.4	199.8
환경관리	38.4	53.2	50.7	47.9	36.3	49.1	39.8	47.6	30.3	35.4	25.2	35.9	-	-	172.8	126.9	-
영업이익	7.5	19.7	5.3	13.9	8.7	21.3	4.9	21.2	-1.1	11.8	-6.4	10.0	16.2	25.2	56.1	14.2	109.0
지배주주순이익	-1.9	-2.5	-0.2	-30.6	-5.4	-7.8	2.2	-15.9	0.4	5.1	-1.2	-2.9	4.9	20.8	-26.9	1.3	77.0
Margin(%)																	
영업이익률	3.3	7.3	1.9	4.1	3.2	7.2	1.8	6.3	-0.4	3.5	-1.7	2.5	3.8	5.2	4.8	1.0	5.5
지배주주순이익률	-0.9	-0.9	-0.1	-8.9	-2.0	-2.6	0.8	-4.7	0.1	1.5	-0.3	-0.7	1.2	4.2	-2.3	0.1	3.9
YoYGrowth(%)																	
매출액	-7.4	-1.9	11.8	34.6	19.1	9.0	-2.3	-2.4	4.3	13.9	40.7	21.3	50.4	45.5	4.8	19.9	41.3
분당 와이어	-13.7	-5.1	3.4	7.1	20.5	17.4	7.4	13.1	17.0	30.7	63.3	57.1	76.6	61.5	14.4	41.9	62.1
골드 증착재	-79.6	-59.0	4.4	5.2	139.3	-14.1	4.7	32.1	-36.0	50.0	45.4	2.8	33.8	6.0	32.3	6.7	30.1
스퍼터링 타겟	-73.7	-63.8	-47.0	4.3	185.6	103.9	77.8	42.5	54.8	-43.3	112.1	61.9	36.3	197.9	89.4	42.9	46.7
솔더볼	-14.0	0.3	-18.3	-11.5	44.8	16.3	7.4	45.3	16.6	25.2	46.6	37.7	36.8	104.1	26.8	31.7	67.7
기타(상품 등)	-86.9	-69.5	392.3	적전	128.2	-40.6	-93.2	흑전	4.9	70.4	83.7	4,111.4	1,336.1	1,369.1	-32.9	1,040.1	154.6
금융	-6.3	-22.4	-1.6	125.2	24.3	-5.3	-12.0	-26.6	-27.4	-7.3	12.2	-40.6	17.3	33.9	-12.5	-22.0	8.4
환경관리	84.0	88.9	95.2	21.1	-5.5	-7.7	-21.6	-0.7	-16.5	-27.8	-36.7	-24.5	-	-	-9.2	-26.6	-
영업이익	-63.6	-34.1	-79.8	305.0	16.4	8.0	-8.8	52.4	적전	-44.7	적전	-52.9	흑전	114.5	20.7	-74.7	668.5
지배주주순이익	적전	적전	적전	적지	적지	적지	흑전	적지	흑전	흑전	적전	적지	1,180.4	310.1	적지	흑전	5,690
QoQGrowth(%)																	
매출액	-10.6	18.5	1.3	25.4	-20.9	8.5	-9.2	25.2	-15.5	18.5	12.1	8.0	4.8	14.6			
분당 와이어	-2.7	13.6	0.6	-3.6	9.5	10.6	-8.0	1.5	13.2	23.6	15.0	-2.4	27.2	13.0			
골드 증착재	-2.3	58.0	-23.5	-11.0	122.3	-43.3	-6.7	12.4	7.6	33.0	-9.6	-20.6	40.0	5.4			
스퍼터링 타겟	-51.9	62.8	-3.6	38.2	31.7	16.2	-15.9	10.7	43.2	-57.4	214.3	-15.5	20.5	-6.9			
솔더볼	-17.7	18.3	11.4	-18.3	34.6	-5.0	2.8	10.6	8.0	2.0	20.4	3.8	7.3	52.2			
기타(상품 등)	-81.3	130.1	592.8	적전	흑전	-40.1	-20.8	42.1	55.7	-2.8	-14.6	3,156.7	-46.9	-0.6			
금융	-30.4	13.8	2.3	178.0	-61.6	-13.3	-4.8	131.9	-62.1	10.7	15.2	22.8	-25.1	26.4			
환경관리	-2.9	38.3	-4.6	-5.6	-24.2	35.1	-18.9	19.6	-36.3	16.7	-28.8	42.5	-	-			
영업이익	117.5	163.1	-72.9	160.9	-37.5	144.2	-77.1	335.8	적전	흑전	적전	흑전	62.2	55.6			
지배주주순이익	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	적전	흑전	1,212.2	적전	적지	흑전	320.3			

자료: FnGuide QuantWise, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

2026F PBR 0.7x

2026F PBR 0.7x로 Peer

덕산하이메탈(PBR 2.0x)

대비 할인

동사의 현주가는 2026F PBR 0.7x로 Historical PBR Band(0.4x~2.0x) 중하단에 위치해 있다. Peer 기업으로는 덕산하이메탈을 선정하였다. 덕산하이메탈은 솔더볼, MSB, CSB 등 반도체 패키징용 접합 소재를 생산하고 있어 국내 상장사 중 동사와 사업 연관성이 가장 높다. 덕산하이메탈의 2026F PBR은 2.0x로 동사 대비 상당한 Premium을 받고 있다. 덕산하이메탈은 MSB, CSB 등 어드밴스드 패키징 비중이 높아 AI 수요에 대한 민감도가 높다는 점에서 Valuation 할증 요소를 보유하고 있다. 동사의 Valuation 할인에는 본딩와이어 중심의 사업구조가 영향을 미친 것으로 판단한다. 본딩와이어는 금 가격 상승분이 판가에 연동되면서 매출 규모가 확대되는 반면 원재료 비중이 높아 매출 성장 대비 이익 레버리지가 제한적이다. 실제 2026F OPM은 5.5%로 덕산하이메탈의 9.7% 대비 낮은 수준이다. 또한 한국토지신탁이 연결 자회사로 포함돼 반도체 소재와 금융 사업이 혼재되어 있고, 금융 부문의 실적 변동성이 연결 실적의 예측 가능성을 낮춘 점도 Valuation 할인 요인으로 판단한다.

다만 동사의 높은 ROE와 빠른 이익 회복을 감안하면 현재의 Valuation Gap은 다소 과도한 수준으로 판단한다. 동사의 2026F ROE는 18.6%로 덕산하이메탈의 13.2%를 상회하며, 2025년 1.0%까지 하락했던 연결 OPM도 2026년 5.5%로 회복될 전망이다. 반도체 소재 부문의 외형 성장과 솔더볼 수익성 개선, 고마진 Pd Alloy의 매출 확대에 더해 금융 부문의 실적 개선까지 더해지면서 연결 이익 체력이 빠르게 회복되고 있기 때문이다. 2027년부터 SoCAMP2와 중국 메모리 CAPA 확대가 본딩와이어의 신규 수요로 연결될 경우 기존 범용 패키징 수요 중심의 본딩와이어 사업에 새로운 성장축이 추가될 전망이다.

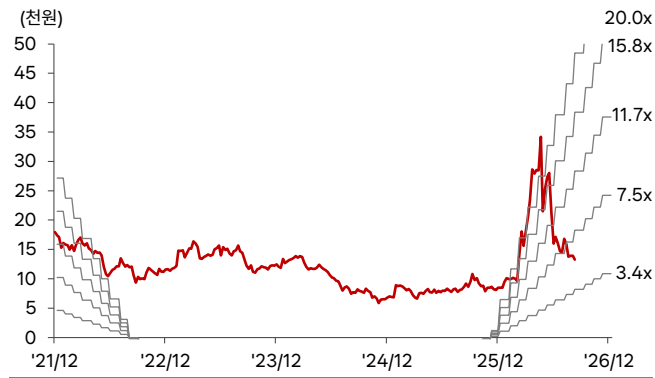
따라서 덕산하이메탈 대비 일정 수준의 할인은 본딩와이어의 낮은 수익성과 금융 자회사를 보유한 사업구조를 감안할 때 합리적이거나, 2026F PBR 0.7x는 이익 개선과 신규 성장동력을 충분히 반영하지 못한 수준으로 판단한다. 향후 반도체 소재 부문의 이익 성장과 금융 부문의 실적 안정화가 확인될수록 Peer 대비 Valuation Gap은 축소될 가능성이 높다고 판단한다.

동종 업종 밸류에이션

기업명	종가	시가총액	매출액(십억 원, 백만 달러)			PER(배)			PBR(배)		
	(원, 달러)	(십억 원, 백만 달러)	2024	2025	2026F	2024	2025	2026F	2024	2025	2026F
코스피	7,052	5,626,430	3,713,280	3,919,857	4,130,685	11.3	15.5	6.8	0.8	1.3	1.7
코스닥	830	466,223	332,962	361,554	138,398	210.6	112.9	23.0	1.5	2.1	2.8
엠케이전자	13,610	334	1,170	1,404	1,984	N/A	140.1	4.2	0.4	0.5	0.7
덕산하이메탈	10,520	478	236	236	337	8.6	N/A	16.3	0.6	1.3	2.0

주: 2026년 09월 09일 종가 기준. 동종그룹 26F는 당사 추정치 사용, 자료: FnGuide QuantWise, Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

엠케이전자 PER Band



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

엠케이전자 PBR Band



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

! 리스크 요인

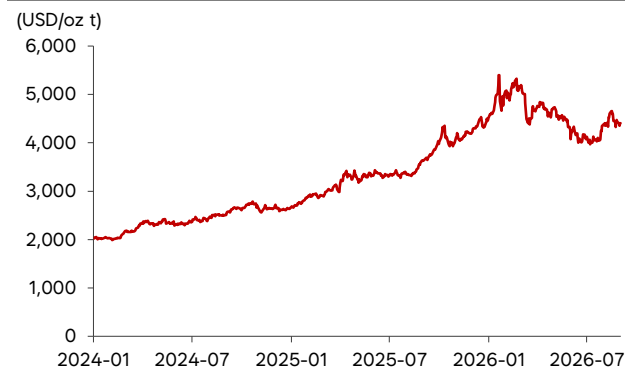
금 가격, 중국 CAPA 및 금융 자회사 변동성에 유의

금 가격·환율 변동, 중국 메모리
CAPA 확대 지연, 한국토지신탁
실적 변동성이 주요 리스크

금 가격 및 환율 변동에 따른 수익성 변동성

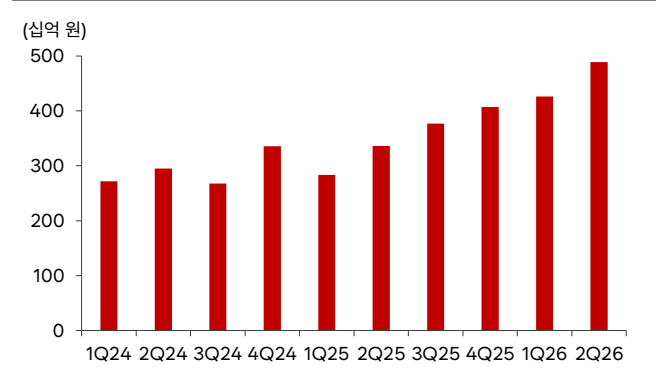
본딩와이어는 금 등 귀금속 원재료 비중이 높고 원재료 가격 및 환율 변동분이 판가에 연동되는 구조이나, 실제 판가 반영까지 일정 시차가 존재한다. 이에 따라 금 가격이나 환율이 단기간에 급격하게 상승할 경우 원재료 가격 상승분의 판가 전가가 지연되면서 단기 수익성이 악화될 수 있다. 반대로 금 가격 및 환율 하락 시에는 판가 하락으로 본딩와이어 ASP가 낮아지면서 외형 성장률이 둔화될 가능성이 있다. 특히 Gold Wire 비중이 높은 국내 본사의 경우 금 가격 및 환율 변동에 따른 실적 민감도가 상대적으로 높다.

금 가격 추이



자료: Investing.com, 한국IR협회의 기업리서치센터

엠케이전자 분기별 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

중국 메모리 CAPA 확대 지연

동사의 중장기 성장 전망에는 CXMT와 YMTC를 중심으로 한 중국 메모리 업체들의 CAPA 확대가 주요 가정으로 반영되어 있다. CXMT와 YMTC의 신규 생산라인 Ramp-up이나 공정 전환 일정이 예상보다 지연될 경우 중국 메모리향 Gold Wire 수요 증가 시점도 늦어질 수 있다. 특히 동사는 기존 시스템반도체 및 OSAT향 Coated Wire 중심의 중국법인 사업을 메모리향 Gold Wire까지 확대하고 추가 CAPA 투자도 검토하고 있어, 중국 메모리 업체들의 실제 생산량 증가 속도가 예상치를 하회할 경우 중국법인의 외형 성장과 수익성 개선 속도도 둔화될 가능성이 있다.

한국토지신탁 실적 변동성

한국토지신탁의 실적 변동성은 연결 실적 및 Valuation의 주요 리스크 요인이다. 금융 부문은 2024년 339억 원의 영업이익에서 2025년 209억 원의 영업손실로 적자전환하며 연결 수익성 하락의 주요 원인으로 작용하였다. 향후 부동산 경기 회복이 지연되거나 신탁사업 관련 프로젝트의 비용 및 총당금 부담이 재차 확대될 경우 금융 부문의 실적 개선 속도가 예상치를 하회할 수 있다. 이 경우 반도체 소재 부문의 이익 성장에도 불구하고 연결 실적의 변동성이 지속될 수 있으며, 금융 자회사로 인한 Peer 대비 Valuation 할인 역시 장기화될 가능성이 있다.

포괄손익계산서

(억 원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	10,232	11,170	11,706	14,038	19,842
증가율(%)	6.8	9.2	4.8	19.9	41.3
매출원가	9,152	10,439	10,849	13,553	18,354
매출원가율(%)	89.4	93.5	92.7	96.5	92.5
매출총이익	1,080	731	857	485	1,488
매출이익률(%)	10.6	6.5	7.3	3.5	7.5
판매관리비	277	267	296	343	398
판매관리비율(%)	2.7	2.4	2.5	2.4	2.0
EBITDA	1,009	674	752	336	1,316
EBITDA 이익률(%)	9.9	6.0	6.4	2.4	6.6
증가율(%)	-20.2	-33.2	11.6	-55.3	291.7
영업이익	803	465	561	142	1,090
영업이익률(%)	7.8	4.2	4.8	1.0	5.5
증가율(%)	-26.0	-42.1	20.7	-74.7	668.5
영업외손익	-482	-527	-368	-288	-242
금융수익	205	191	263	278	254
금융비용	478	371	567	488	508
기타영업외손익	-209	-347	-64	-79	13
종속/관계기업관련손익	-213	-392	-640	512	380
세전계속사업이익	107	-455	-447	366	1,228
증가율(%)	-93.9	적전	적지	흑전	248.6
법인세비용	76	-64	-70	228	280
계속사업이익	31	-391	-377	138	958
중단사업이익	-0	-0	-0	-0	46
당기순이익	31	-391	-377	138	994
당기순이익률(%)	0.3	-3.5	-3.2	1.0	5.0
증가율(%)	-97.4	적전	적지	흑전	621.8
지배주주지분 순이익	-116	-352	-269	13	770

현금흐름표

(억 원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	802	-3,257	1,664	-1,593	-1,143
당기순이익	31	-391	-377	138	994
유형자산 상각비	172	175	164	169	223
무형자산 상각비	34	34	27	25	3
외환손익	36	10	36	29	0
운전자본의감소(증가)	0	-3,854	699	-2,264	-2,349
기타	529	769	1,115	310	-14
투자활동으로인한현금흐름	-1,331	498	-1,058	-193	-1,088
투자자산의 감소(증가)	-1,215	1,361	-811	-176	-813
유형자산의 감소	1	1	0	1	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-88	-451	-137	-42	-250
기타	-29	-413	-110	24	-25
재무활동으로인한현금흐름	-221	1,372	315	677	543
차입금의 증가(감소)	53	1,997	1,309	1,021	568
사채의증가(감소)	-4	-238	-613	-216	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-170	-145	-109	-109	-26
기타	-100	-242	-272	-19	1
기타현금흐름	-9	-1	29	-6	12
현금의증가(감소)	-759	-1,388	951	-1,115	-1,676
기초현금	4,007	3,248	1,859	2,810	1,695
기말현금	3,248	1,859	2,810	1,695	19

재무상태표

(억 원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	2,708	2,777	9,892	10,825	12,362
현금성자산	534	349	2,810	1,695	19
단기투자자산	34	72	72	61	87
매출채권	1,128	1,238	1,658	1,971	2,565
재고자산	746	745	759	1,240	1,413
기타유동자산	267	373	4,593	5,858	8,279
비유동자산	1,812	1,436	13,250	14,515	15,352
유형자산	600	609	876	871	898
무형자산	1,035	666	571	440	437
투자자산	68	56	6,245	7,482	8,295
기타비유동자산	109	105	5,558	5,722	5,722
자산총계	21,700	23,079	23,142	25,340	27,714
유동부채	3,560	3,985	8,929	10,988	12,313
단기차입금	2,896	2,936	5,315	6,139	6,989
매입채무	323	264	360	542	638
기타유동부채	341	785	3,254	4,307	4,686
비유동부채	1,038	534	5,073	4,337	4,421
사채	440	70	1,884	1,709	1,709
장기차입금	33	0	1,790	969	629
기타비유동부채	565	464	1,399	1,659	2,083
부채총계	11,526	13,308	14,001	15,325	16,734
자배주주지분	3,907	3,770	3,439	3,778	4,519
자본금	109	110	110	113	113
자본잉여금	579	745	781	1,033	1,033
자본조정 등	-149	-149	-188	-179	-179
기타포괄이익누계액	-158	-81	43	93	93
이익잉여금	3,375	2,995	2,692	2,719	3,460
자본총계	10,175	9,771	9,141	10,015	10,980

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	N/A	N/A	N/A	140.1	4.2
P/B(배)	0.6	0.7	0.4	0.5	0.7
P/S(배)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
EV/EBITDA(배)	11.6	17.6	20.9	55.2	17.0
배당수익률(%)	0.9	0.8	1.5	1.4	0.9
EPS(원)	-531	-1,602	-1,218	60	3,211
BPS(원)	17,914	17,087	15,585	16,718	18,398
SPS(원)	46,920	50,784	53,049	63,302	82,737
DPS(원)	100	100	100	120	120
수익성(%)					
ROE	-2.9	-9.2	-7.5	0.4	18.6
ROA	0.1	-1.7	-1.6	0.6	3.7
ROIC	6.6	10.4	12.9	3.0	12.0
안정성(%)					
유동비율	76.1	69.7	110.8	98.5	100.4
부채비율	113.3	136.2	153.2	153.0	152.4
순차입금비율	29.5	32.1	94.0	103.8	114.9
이자보상배율	4.7	2.4	2.6	0.7	4.9
활동성(%)					
총자산회전율	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
매출채권회전율	8.5	9.4	8.1	7.7	8.7
재고자산회전율	13.5	15.0	15.6	14.0	15.0

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 주기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
엠케이전자	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2026.09.11	엠케이전자-새로운 수요처가 열리는 본딩와이어
2023.11.22	엠케이전자-점진적인 본딩와이어 수요 회복 기대

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 저작권재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/krirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '소중한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '소중한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.